

週間半導体ニュース

2026年8月24日 ～ 8月30日

Hot Chipsでカスタムシリコンがデータセンターから車載まで一斉に姿を現した週。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

出典：NVIDIA、Apple、Waymo、Hot Chips、SEC、ホワイトハウス、Tom's Hardware、CNBC
ほか

★ 今週の注目3本

962億ドル

NVIDIA 第2四半 期売上高

データセンターは890億ドルで前年同期比117%増。Vera Rubin量産を軸に第3四半期は1080億ドルを見込むが、中国向け需要はゼロと置く。 (NVIDIA発表、8/26)

1.9倍

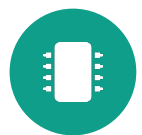
OpenAI初の自社 ASIC

Broadcomと共同開発したOpenAI初の自社チップ「Jalapeño」。700Wで、1200WのGB200と1400WのGB300に対し電力あたり最大1.9倍のピーク処理量を主張する。 (Tom's Hardware、8/27)

20倍

Waymo車載演算 の8年間の伸び

Hot Chips初日に自社の5nmセンサーフュージョン・プロセッサを公開した。累計2億マイル超の完全自動走行を背景に、車載演算を8年で20倍に拡大したとしている。 (Waymo、8/24)



AIチップ・GPU

1 NVIDIA、四半期売上高962億ドル

7月26日締めの上四半期は前年同期比106%増の962億ドル、データセンターは890億ドル。粗利益率は75.0%、希薄化後EPSは2.46ドル。牽引役として挙げられたのはBlackwellではなくVera Rubinである。 (NVIDIA発表、8/26)

2 NVIDIA Groq 3 LPX が量産開始

Hot Chipsに合わせ「対話型AI推論アクセラレータ」として量産入り。Artificial Analysis計測でGemma 4 31Bの10万トークン文脈に毎秒3400トークン、競合最速比4倍の応答性を主張する。 (NVIDIA発表、8/24)

3 OpenAI、推論ASIC「Jalapeño」を詳説

HBM4を216GiB搭載し帯域15.4TB/s、700Wで13.4 PFLOPS (MXFP4)。ラック128基、16ラックのポッドで2048基まで拡張する。学習は行わず、Vera Rubinとの比較も未実施だ。 (Hot Chips、8/25)

4 Cerebras、ウエハースケールの次世代を提示

CS-4はラック基盤「Nexus」の第1号で、CS-3比でメモリ帯域・演算・IOが6倍という。次々世代のCS-6ではウエハー規模でDRAMを積層し、SRAM偏重ゆえの容量制約に手を打つ。 (Cerebras／Hot Chips、8/26)

製造・サプライチェーン

① Micron、HBMのシリコン消費は世代ごとに悪化

同容量ならHBMはDDR5の約3倍のウエハー面積を要し、状況は「良くなってはいない」と説明した。16層までは道筋が見えるが、その先には多くの課題が残るという。HBM4Eではベースダイの製造をTSMCへ移す。 (Hot Chips、報道8/26)

② SK hynix、ハイブリッドボンディングをHBM5に先送り

HBM4E世代では見送り、Rubin世代まで従来のMR-MUFを継続する。16～20層の安定した銅接合が依然として未解決で、積層高さの上限は720から775マイクロメートルに引き上げられた。(Hot Chips、8/25)

③ Intel、14Aの欠陥密度が計画曲線を上回る

ジンズナー最高財務責任者は「22nm以来の水準」と述べた。ただし量産2年前の改善ペースの話であり、現時点の絶対値ではない。リスク生産は2027年後半、量産は2028年を予定する。(Deutsche Bank会議、8/26)

コンシューマー向けチップ

① Apple、初の2nmチップ「M6」搭載Mac miniを発表

AppleはM6を「同社初の2nmチップ」と説明し、12コアCPUはM5より2コア多い。M4搭載の前世代Mac miniと比べAI処理は最大4倍、CPUは40%高速という。899ドルから、出荷は9月22日。 (Apple発表、8/25)

② Samsung、演算機能を組み込んだLPDDR5Xを公開

DRAMセルの隣に演算ユニットを置くLPDDR5X-PIMを「LPDDR系で世界初」として発表。推論速度は2.28倍、トークン処理量は3.01倍、帯域は614GB/sで従来の約8倍とされる。 (Hot Chips、8/25)

③ AMDが2027年にCPU市場でIntelを抜くとの見方

Raymond JamesのSimon Leopold氏がAMDを最上位判断に引き上げ、目標株価を565ドルから641ドルへ。エージェント型AIを新たな成長源とし、2030年のCPU市場を約2010億ドルと見積もる。 (CNBC、8/25)



ハイパースケーラーと米DC・電力

1 Hot Chipsはハイパースケーラー自社チップの見本市に

GoogleはTPU第8世代を学習用と推論用の2チップ構成として公開。MicrosoftのMAIA 200はTSMC 3nmで1400億超のトランジスタとHBM3E 216GBを750Wに収める。MetaはMTIA 400を新たに示した。 (Hot Chips、8/24-25)

2 NVIDIA、AIファクトリー全体の電力制御を提案

個々のラックではなく敷地全体で電力の立ち上げ方を管理する「DSX MaxLPS」を説明した。系統運用者がピーク挙動で接続条件を決める中、制御可能な負荷は立地交渉の材料になりつつある。 (Hot Chips、8/25)

3 西テキサスの巨大DCが2.5億ドルの周辺契約を生む

Target Hospitalityは大手ハイパースケーラーのペコス地区データセンター開発向けに、2030年8月までに約2.5億ドルの売上を見込む複数年契約を締結。設備投資は1500万ドル未満にとどまる。 (SEC提出書類、8/26)

自動運転・車載半導体

① Waymo、センサーフュージョン・プロセッサを公開

Hot Chips初日に基調講演と技術講演の2枠で登壇。5nmの自社チップは走行判断の中核ではなく前段に置かれ、生のライダー・レーダー・カメラ信号にノイズ除去と初段の推論を施す。冗長化のため2系統が並列動作する。 [\(Hot Chips、8/24\)](#)

② 「1000 TOPS超」は単体ではなくシステム値

ブログの表現が1チップの値と広く読まれ、NVIDIA DRIVE AGX Thorと比較された。同社は「システム全体の値であり単体チップではない」と訂正した。車載向け汎用品と比べる際に効いてくる違いである。 [\(TechCrunch、8/30\)](#)

③ Waymo、ミュンヘンで下準備を開始

「完全自動運転の配車サービスに向けた地ならしを進める」と発表した。商用開始は2027年末を目標とし、当面は手動走行と高精度地図の作成にあたる。米国では11都市で一般向けに運行している。 [\(Waymo、8/25\)](#)

④ 自動運転トラックのGatikが2億ドルのシリーズD

カタール投資庁とKoch Disruptiveが主導し、ARK Investらが参加した。6月に公表したPepsiCoとの複数年契約では41台を無人運行する。受注残は全社で6億ドル超としている。 [\(TechCrunch、8/25\)](#)



スタートアップと投資

4千万ドル

Quintessent (シリーズA)

Cycle Capitalが主導し、Goldman Sachsやシエナも参加した。シリコンフォトニクス上に量子ドットDWDMコム光源を1チップ化し、AIデータセンターの光接続を狙う。 [\(BusinessWire、8/24\)](#)

3千万ドル

Celera Semiconductor (シリーズB)

筆頭株主のMaverick Siliconが全額を出資した。「Nesto」をアナログ機能のデジタルツイン・ライブラリとして業界初と位置づけ、EDAの恩恵が届きにくかった領域の設計時間と費用を削る。 [\(PR Newswire、8/25\)](#)

2450万ドル

Agentrys (シード+プレシード)

Etna Labs主導の1910万ドルのシードに、MediaTek主導の540万ドルのプレシードを加えた。全工程を対象とするエージェント型設計自動化を掲げ、新資金は検証と物理設計に充てる。 [\(Agentrys、8/26\)](#)

100 TB/s

d-Matrix、「Raptor」を公開

TSMC 4nmの演算ダイを36マイクロメートル間隔で独自DRAMに直接接合し、カード当たり32GBで100TB/sを実現。本会議ではなくチュートリアルでの発表だった。 [\(Hot Chips、報道8/26\)](#)



業界再編と政策

NVIDIA、Hugging Face買収を交渉中と報道

The Informationは129億ドルで合意と報じ、Business Insiderは130億ドル超で未署名と伝えた。両社とも発表しておらず、一次資料は存在しない。 (CNBC、8/27)

送電機器をめぐり国家非常事態を宣言

大統領令14420はエネルギー省に120日以内の規則整備を求める。変電用変圧器、インバーター、蓄電池、遮断器などが対象で、既設分の運用にも条件を課しうる。特定の国名は挙げていない。 (大統領令14420、8/26)

米、半導体関税の対象拡大を検討

ノートPC、データセンター用サーバー、ゲーム機まで広げる案が議論されている。免除ではなく、対米投資量に応じた無税枠という構想だと報じられた。 (Politico／CNBC、8/27)

輸出規制が業績見通しに定着

NVIDIAは第3四半期見通しで中国向けデータセンター需要をゼロと置いた。一時的な逆風ではなく恒久的な前提として織り込まれた形である。 (NVIDIA発表、8/26)



日本への含意

今週の材料から、日本の各セクターに読み取れる論点。

材料メーカー

HBMが同容量でDDR5の約3倍のウェハー面積を使うというMicronの説明は、信越化学やSUMCOの数量拡大が続くことを意味する。775マイクロメートルの上限は、JSRや東京応化、レゾナック、味の素の平坦性競争を厳しくする。

装置メーカー

SK hynixがRubin世代までMR-MUFを続ける判断は、東京エレクトロンの接合・塗布装置に猶予を与え、ディスコの薄化需要を押し上げる。HBM4Eのベースダイ移管はアドバンテストの検査工程を増やす。

ファウンドリ

富士通のMonakaは2nmコアダイがTSMC N2P、キャッシュとIOがN5である。設計できても国内で作れない現実が、ラピダスの意義を示す。Waymoが挙げるパートナーにもソシオネクストの名があるが、役割は明示されておらず同社の発表もない。

政府

関税がサーバーやノートPCに及べば日本の電子機器輸出に直撃する。台湾の先例が示すとおり仕組みは免除ではなく数量枠だ。送電機器の大統領令は既設分にも及ぶため、120日の規則整備期間が同盟国扱いの分かれ目となる。



主な出典

- [NVIDIA — 第2四半期決算 発表 \(8/26\)](#)
- [NVIDIA — Groq 3 LPX 量産開始 \(8/24\)](#)
- [Waymo — センサーフュージョン・プロセッサ公開 \(8/24\)](#)
- [Hot Chips 2026 — 講演プログラム \(8/23-25\)](#)
- [Apple — M6／M5 Pro 搭載 Mac mini \(8/25\)](#)
- [ホワイトハウス — 大統領令14420 \(8/26\)](#)
- [SEC EDGAR — Target Hospitality 8-K \(8/26\)](#)
- 二次資料：Tom's Hardware、ServeTheHome、CNBC、TechCrunch。2026年8月30日に一次資料で検証済み。

各項目の出典表記は元記事へのリンクになっています。